

**NEWS ANNOUNCEMENT**

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

\* 2017 年 4 月 12 日に発表されたプレスリリースの抄訳です。

**タワージャズとアイシン精機が次世代の車載製品の量産を発表**  
**アイシンの自動車メーカー向けチップ、タワージャズの先進的なパワーマネジメント技術を使用して生産**

ミグダルハエメク(イスラエル)および刈谷(日本)、2017 年 4 月 12 日 – グローバルスペシャルティファウンドリリーダーのタワージャズと、世界大手自動車部品サプライヤーの 1 社であるアイシン精機株式会社は、本日、タワージャズのパワーマネジメントテクノロジーを使用して、自動車メーカー向け車体製品に使われるアイシンの次世代車載用デバイスを量産することを発表しました。

タワージャズのパワーマネジメントプラットフォームは、面積効率の高いスケーラブルな LDMOS および ESD デバイス、特許取得済みの信頼性の高い Y フラッシュ OTP / MTP ソリューション、埋込み型ツェナーダイオード、ショットキーダイオード、その他先端の機能を提供し、車載用チップとして業界をけん引する性能を実現します。

タワージャズは、パナソニック・タワージャズセミコンダクター社 (TPSCo) の日本工場にパワーマネジメント技術の可用性を拡大しています。タワージャズとアイシンは車載製品製造実績を持つ TPSCo の 200mm 工場でも製品製造を計画し、マルチファブ製造の柔軟性を得ることを期待しています。

アイシン精機株式会社 電子商品本部 電子先行開発部 主査の後藤浩次氏は次のように述べています。「タワージャズの先進的なパワーテクノロジープラットフォームを利用することで、当社の仕様に合わせてチップを容易にカスタマイズすることができます。タワージャズと車体製品開発で緊密に連携することで、高品質な自動車部品を効率よく確実に量産することができるでしょう。」

タワージャズのバイスプレジデント兼ミックスドシグナルおよびパワーマネジメント部門ゼネラルマネジャーの Shimon Greenberg は次のように述べています。「タワージャズは、180nm AEC-Q100 グレード 0 認定プロセスプラットフォームをベースにした先進的なパワーマネジメントテクノロジーで、成長を続ける自動車用半導体市場に優れた品質の製造ソリューションを提供する体制が整っています。当社は、アイシンとの密接な関係を強化し、次世代の車載用デバイスを製造することを期待しています。アイシンの世界的な車載部品サプライヤーとしてのリーダーシップと当社のクラス最高のパワーマネジメントプラットフォームとが組み合わさることで、急成長する自動車市場で画期的な製品を実現します。」

## アイシン精機について

アイシン精機はエンジン関連やブレーキ関連、ボディ関連、電子関連など、高度な技術力であらゆる自動車部品を生み出し、世界のお客様に提供しています。さらに、自動車部品で培った技術を活かし、住生活、エネルギー、医療など、その事業フィールドは広がり続けています。アイシンは、世界中で 180 社の連結会社を持ち、8 万人の従業員を抱えています。詳細については、<http://www.aisin.com/>を参照してください。

## タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE:TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社とタワージャズテキサス社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシングナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセス技術を幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントプラットフォームを提供し、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS)を提供しています。

複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)のファブに加え、タワージャズが過半数の株式を保有するパナソニック社と設立したパナソニック・タワージャズセミコンダクター社(TPSCo)の日本の 3 拠点(200mm と 300mm)のファブと連携しています。TPSCo を通じて、タワージャズは、最先端のイメージセンサ技術を含む、先端の 45nm CMOS、65nm RF CMOS および 65nm 1.12um ピクセル技術の提供が可能となります。詳細は [www.towerjazz.com](http://www.towerjazz.com) または [www.tpsemico.com](http://www.tpsemico.com) をご覧ください。

**TowerJazz Asia-Pacific Company Contact:** Shoko Saimiya | [Shoko.saimiya@towerjazz.com](mailto:Shoko.saimiya@towerjazz.com)

**TowerJazz Investor Relations Contact:** Noit Levi | +972-4-604-7066 | [noit.levi@towerjazz.com](mailto:noit.levi@towerjazz.com)